

株式会社東京精密 2024年度(2025年3月期) 第1四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2024年8月2日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2024年度(2025年3月期) 第1四半期 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
 - 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
 - なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。
1. **4-6月期のSPE受注高は、想定を上振れた模様だが、その詳細を聞きたい。**
 - 中国向けで、スマートフォンサプライチェーンと想定されるIDMやOSAT向け案件が想定より多かった。
 - メモリと比較すると、ロジック向けの案件が多かった。
 2. **4-6月期、両事業とも営業利益率が前年同期比で低下している背景を聞きたい。**
 - 半導体の低採算案件の売上のほか、販管費、特に2023年度に竣工した飯能工場(埼玉県)、子会社でのERP採用に伴う経費ならびに減価償却費の増加が主因。
 - なお、今回2024年度通期業績予想を開示しているが、償却前営業利益は2021年度を上回る水準の計画。引き続き利益率向上に取り組む。
 3. **4-6月期に半導体で受注取消処理はあったのか?**
 - 当社は四半期毎に受注残高の精査を行い、確度が低下した案件は社内的な取消処理を行っている。4-6月期も取消処理を行ったが、極めて軽微な水準だった。
 4. **現在のSPEのリードタイムを伺いたい。**
 - プローバ・ダイサは通常納期となっている(プローバは飯能工場竣工による生産キャパシティ増加も寄与)。グラインダは引き続き高稼働率であるが、八王子工場のグラインダ生産キャパも拡大しており、短納期対応も可能な状況。
 - 2025年度夏の名古屋工場竣工によりグラインダの生産キャパはさらに増加する。
 5. **4-6月期の生成AI関連受注高・売上高の規模、今後の受注見通しを聞きたい。**

- 4-6 月期は、上期想定規模の概ね半分程度の受注(HBM 向けが多い)があり、7-9 月期も同水準の受注を見込んでいる。
 - 下期以降だが、顧客よりフォーキャストの情報を共有いただくのが難しいことに加え、短納期の製品が多いため、見通しを予想することは難しい。しかし、定性的には、非常に強い需要が継続すると見込んでいる。
 - なお、上期の生成 AI 関連の売上高は、前年下期比+数 10%を見込んでいるが、4-6 月期はその半分程度を計上している。
6. 7-9 月期の SPE 受注見通しは、前四半期比 10%程度の減少を想定しているが、この背景を伺いたい。
- 多少保守的に見ているのは否定しない。装置発注に至らないまでも、顧客の稼働率改善は続いており、モメンタムが悪化しているとは感じない。
 - なお、7-9 月期の受注高のガイダンスは、期初の社内計画水準と近似しており、むしろ 4-6 月期の受注が想定以上に堅調だったともいえる。
7. 2024 年度上期の業績予想だが、計測の売上計画を、納入予定の延伸を主因に下方修正している。詳細についてコメントを頂きたい。
- 特定の製品や業界向けに延伸が発生したというよりも、個別案件において顧客要請による延伸がいくつか発生したことが要因の一つ。他には、例えば当社の三次元座標測定機の付属品がサプライヤの納期遅れで同梱できなかつたため、売上計上が延伸した、などである。(既にサプライヤからの納入は正常化済)
8. 今回開示された 2024 年度通期業績予想の SPE 売上高は、上期・下期同額で設定されている。この前提となる受注高の見通しについて見解を頂きたい。
- 期初時点では、2024 年度受注の民生エレクトロニクス需要の回復があり得ると想定していたため、上期予想のみ開示していた。
 - しかし現時点でもその回復時期は見通しづらい状況は継続。このまま下期計画を非開示にすることは逆に当社の環境認識が正確に伝わらない可能性があったため、現時点での受注残高や受注動向をもとにした通期予想を開示したもの。その結果、上期と下期の売上予想が同額になった。
 - 今後の SPE の受注見通しだが、まず 4-6 月期の実績を説明する。
 - アプリケーション別：メモリ向け 10%半ば(うち 8 割が DRAM)、ロジック向けが 50%程度、電子部品・ディスクリート系が 20%程度、パワー半導体が 10%程度であった。
 - 地域別：中国が、従前の水準(35~40%程度)から、50%台前半まで上昇。
 - 今後の受注見通しだが、①メモリ向けは AI 用途の増減が見通しづらい状況、②

概ねロジック向けでは全体の半分程度、電子部品が2割程度、という環境に大きな変化は無い③またパワー系若干低下する可能性がある、と想定しているが、総じて大きく変化する可能性は小さいと考えている。

- SiC に関しては、基板向けを中心とした装置需要からデバイス関係に移ってゆくという前提に変更はないものの、EV 需要の一時的鈍化などで足許の装置需要が停滞しており、その状況を見定めてゆく必要があると考えている。
- 中国需要は、50%台の水準が続くかは分からないが、高水準で推移する可能性を想定している。
- 民生アプリケーション需要の回復時期について想定することは難しい。通期業績予想は、年度中の回復は想定していないものをご理解いただきたい。

9. SPE の収益性について、今後 生成 AI 関連売上増進によって改善が見込めるのか。

- 生成 AI 関連の製品の収益性は比較的高いことは事実だが、SPE の売上ミックス、工場稼働率、他販管費の動向などを加味して見る必要がある。いずれにしても、上期の営業利益率は、4-6 月期に比べ改善が見込まれる。

10. Hybrid Bonding の適用時期に関する見通しを確認したい。

- 暦年 2025 年後半から 2026 年前半に装置需要が増加、当社グライндаの事業機会に期待するという当初見通しに変更はない。
- 現時点ではそのための顧客評価が行われており、順調に進んでいる。
- なお、今回の決算説明会資料 P8 (業績予想前提) において、Hybrid Bonding に関する記載を省略したが、これはもとより 2024 年度の業績に影響がない項目であったため。

11. SoC テスタ市況が急速に回復しているとの見解が市場にあるが、事実であれば当社にも事業機会が発生するとの理解でよいのか。

- あくまで一般論だが、Wafer Testing 用テスタ市場の拡大は、プローバ市場の拡大と連動する可能性はある(1 対 1 で接続されるため)。
- 一方で、プローバとテスタの納期差や、顧客ミックス等によって、テスタと異なるタイミングや市場規模を認識する可能性がある。
- また、ハイエンドデバイスの検査に当たり、高精度温度制御などプローバに求められる技術要求が高くなっており、シェア動向にも影響が出る可能性もあるものと考えている。

以上